

Hochreiner PTFE Nassreinigung Blumenkorb Einzelscheiben-Ätzgestell Anpassbar 4-Zoll-Maskenträger

Artikelnummer: PL-CP66



Einführung

Hochreine PTFE Nassreinigungs-Blumenkörbe bieten außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit für die Halbleiterwaferverarbeitung. Diese anpassbaren Ätzgestelle gewährleisten kontaminationsfreies Tauchreinigen und Handhabung für empfindliche Substrate in anspruchsvollen Labor- und Industrieumgebungen. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Fluorpolymer-Lösungen.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Wichtigster Vorteil
Halbleiterwafer-Reinigung	Tauchreinigung von Siliziumwafern in RCA-Reinigungssequenzen (SC-1 und SC-2) zur Entfernung organischer und metallischer Verunreinigungen.	Verhindert Kreuzkontamination und gewährleistet hochreine Verarbeitung.
Nasschemisches Ätzen	Präzisionsätzen von Dünnschichten (SiO_2 , Si_3N_4) in Flusssäure- oder Phosphorsäurebädern bei erhöhten Temperaturen.	Behält strukturelle Integrität in aggressiven Säureumgebungen bei.
Maskenplatten-Verarbeitung	Spezialisierte Handhabung und Reinigung von Photomasken für die Lithographie zur Gewährleistung eines defektfreien Mustertransfers.	Präzise Schlitzung verhindert kontaktbedingte Schäden an der Maskenoberfläche.
Solarzellenherstellung	Massenverarbeitung von Siliziumwafern für Texturierung und Entfernung von Phosphorsilikatglas (PSG).	Hoher Durchsatz und Haltbarkeit in hohen Produktionszyklen.
Vorbereitung von leitfähigem Glas	Reinigung und Vorbereitung von ITO/FTO-beschichtetem Glas für die Optoelektronik- und Displayherstellung.	Minimale Kontaktpunkte verhindern Kratzer auf empfindlichen leitfähigen Schichten.
MEMS-Entwicklung	Handhabung von mehrschichtigen mikroelektromechanischen Systemen während komplexer Ätzprozesse für Opfer Schichten.	Chemische Inertheit gewährleistet, dass empfindliche Mikrostrukturen nicht geschädigt werden.
Labor-Forschung und Entwicklung	Kleinserien-Substratbehandlung in der akademischen und industriellen Forschung für die Entwicklung neuartiger Materialien.	Vielseitige Anpassung ermöglicht nicht standardmäßige Substratformen und -größen.

Parameter	Spezifikationsdetails (Modell: PL-CP66)
Materialzusammensetzung	100 % hochreines reines PTFE (Polytetrafluorethylen)
Maximale Betriebstemperatur	+260 °C (dauerhaft)
Minimale Betriebstemperatur	-200 °C
Chemische Kompatibilität	Universell (pH 0-14); Beständig gegen HF, Königswasser, Piranha-Lösung
Standard-Substratgröße	4 Zoll (100 mm) – anpassbar für alle Durchmesser
Schlitzkonfiguration	Einzelwafer- oder Mehrfachwafer-Varianten verfügbar
Schlitztiefe/-breite	Vollständig anpassbar an Substratdicke und Stabilitätsanforderungen
Griffdesign	Fest vertikal, abnehmbar oder schwenkbare Griffe (anpassbar)

Anwendung	Beschreibung	Wichtigster Vorteil
Parameter	Spezifikationsdetails (Modell: PL-CP66)	
Fertigungsmethode	Präzisions-CNC-Bearbeitung (keine Verunreinigung durch Formgebung)	
Oberflächenfinish	Hochglattes, porenarmes bearbeitetes Finish	